N800C

ノンシリコン熱伝導シート

LiPOLY N800C はノンシリコーン樹脂の材料で作りました。低分子シロキサの揮発は少ないので、電子回路接点不良という状況はなりません。N800C は良い熱伝導性があって、熱伝導率は 17.0 W/m*Kです。熱抵抗も低いて、光学製品や敏感な電子部品の使用には適合です。

製品の特性

/ 熱伝導率: 17.0 W/m*K
/ ノンシリコーン材料
/ 接触熱抵抗が小さい
/ 電気絶縁
/ 優れる熱伝導率
/ 光学デバイスに適合

製品アプリケーション

/ ハードディスク
/ 光学デバイス
/ 5Gの基地局(基幹施設/設備)
/ 電気自動車

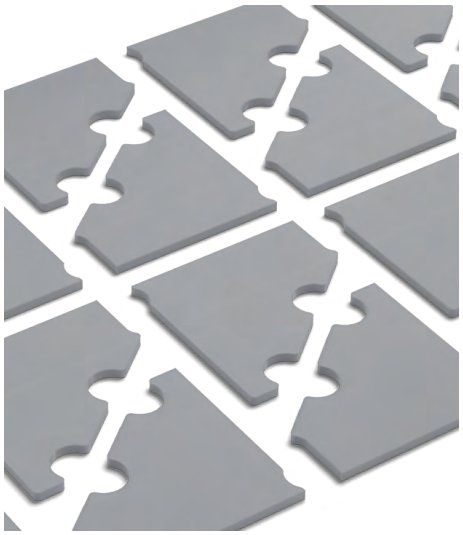
製品の形

/ シート状
/ フォーミング形

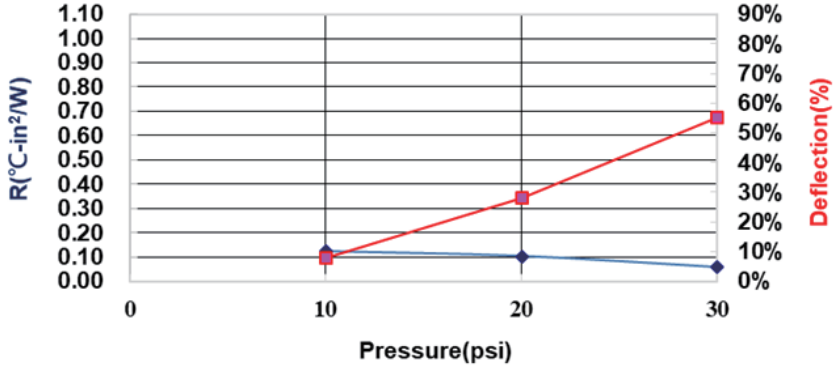
代表特性

物理特性	N800C	試験方法	単位
色	Gray	Visual	-
表面粘着性（2面 / 1面）	2	-	-
厚さ	Customized	ASTM D374	mm
密度	3.3	ASTM D792	g/cm³
硬さ	50	ASTM D2240	Shore OO
使用温度	-60~125	-	°C
低分子シロキサン (D3～D20合計)	N.D	Gas Chromatography	%
脱ガス CVCM (wt%)	0.0043	By LiPOLY	-
ROHS & REACH	Compliant	-	-
圧縮特性@1.0mm			
圧縮率 @10 psi	8	ASTM D5470 modify	%
圧縮率 @20 psi	28	ASTM D5470 modify	%
圧縮率 @30 psi	55	ASTM D5470 modify	%
電気特性			
絶縁破壊電圧	8	ASTM D149	KV/mm
表面抵抗率	$>10^{11}$	ASTM D257	Ohm
体積抵抗率	$>10^{10}$	ASTM D257	Ohm-m
熱特性			
熱伝導率	17.0	ASTM D5470	W/m*K
熱抵抗@10 psi	0.122	ASTM D5470	°C-in²/ W
熱抵抗@20 psi	0.103	ASTM D5470	°C-in²/ W
熱抵抗@30 psi	0.058	ASTM D5470	°C-in²/ W

環状ポリジメチルシロキサン（$HO-[Si(CH_3)_2O]_n-H$）は、
化学反応が起こっていない状態でも、常温環境下で容易に揮発します。たとえば、密閉された電子機器内部では、低分子シロキサンが揮発して電子接点に付着し、接触不良を引き起こすおそれがあります。



熱抵抗 vs. 圧力 vs. 圧縮率



LiPOLY のすべての仕様は予告なしに変更されることがあります. LiPOLY は TIM テスター法および ASTM D5470 試験法を LiPOLY の定義として使用しています. 購入者が要求した製品の特定の目的、性能、および品質は保証されません.購入者は、使用前にその安全性を評価および検証する必要があります。また、必要な特定の条件について事前に製品をテストし、期待される性能を検証する必要があります。 製品の使用および適用に対する責任はエンド ユーザーにあります. LiPOLY は、目的への適合性、商品性、または特定または一般的な目的のための材料または製品の非侵害の保証を否認します. LiPOLY は、偶発的または一般的な責任. すべての LiPOLY 製品は、その時点で有効な LiPOLY の販売条件に従って販売されるものとし、そのコピーは、コンプライアンスに基づいて提供されるものとします. LiPOLY. 無断複写・転載を禁じます. LiPOLY の商標、および LiPOLY またはその関連会社を含むすべての権利は留保されています. 他の製品またはサービス名は、第三者の所有物である可能性があります. この記事のいかなる内容も、LiPOLY またはその知的財産権に対する第三者へのライセンスを提供するものではありません. 仮説または推奨事項は、特許が侵害されていないことを保証するものではありません. Copyright LiPOLY